
VISUALIZE THE FUTURE



2017年3月期 第2四半期

決算説明会

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル

2016年11月17日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

- 1 2017年3月期 第2四半期 決算説明**
- 2 2017年3月期 通期業績予想**
- 3 中期経営計画と成長イメージ**
- 4 参考資料**

- 1 2017年3月期 第2四半期 決算説明**
- 2 2017年3月期 通期業績予想
- 3 中期経営計画と成長イメージ
- 4 参考資料

グローバル

- スマートフォン分野の減速が続くものの、メモリーや車載機器、産業機器向けの需要が好調に推移
 - 第三四半期(7-9月)の世界売り上げは過去最高の\$88.3 billion前四半期比**11.5%増**※1
 - 2015年～2018年の年平均成長率は**+0.6%**。2018年には市場規模3,409億ドルを見込む※2
- セットメーカーが半導体内製化を推進 (Apple, Huawei, Samsung)する一方、主要半導体ベンダーは急速にIoT、自動車分野へシフト
- 中国セット・メーカーとファブレス半導体ベンダーが台頭

国内

- 2016年はマイナス成長に転じるものの、2018年まで緩やかに回復し、2018年には市場規模3兆6,298億円を見込む

(※1) 2016/10/3 The Semiconductor Industry Association (SIA)発表

(※2) 2016/6/7 WSTS日本協議会発表

取組み

IPライセンスの受注活動に
注力

新世代3DグラフィックスIP
コアの開発 (※1)

NEDO (※2) によるIoT推進公募プロ
ジェクトの委託先として採択

VF3(後継チップ)の開発を推進

結果

売上：前年同期比約3割増

- ✓ 既存顧客からのランニングロイヤリティが堅調に推移
- ✓ 保守サポート収入も貢献
- ✓ NEDOの公募プロジェクトに関する受託売上を計上

利益：営業損失を計上

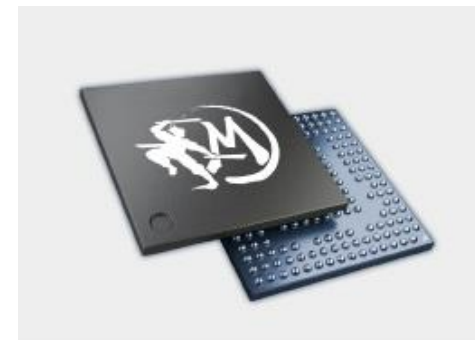
- ✓ 次世代SoCの研究開発費の発生

※1 詳細6ページ

※2 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

1 新3DグラフィックスIPコア「M3000シリーズ」の提供開始 (2016年8月9日公表)

- ▶ 小型化と高性能化を同時に実現
 - ・ 前世代「SMAPH-S」と比べて性能は約6倍の向上
 - ・ ARM GPUコアに比べ三分の一の面積で同等性能を達成



2 NEDOの「IoT推進のための横断技術開発プロジェクト」を受託 (2016年7月8日公表)

- ▶ 「省電力AIエンジンと異種エンジン統合クラウドによる人工知能プラットフォーム」の開発に着手 (*)



3 戦略的提携の推進

- ▶ UKCホールディングスとの提携については、SoC/モジュールビジネス及びプロフェッショナルサービス分野において共同で営業活動を展開

(*) 詳細16,17ページ

(単位：百万円)

	2016年3月期 第2四半期 (実績)	2017年3月期 第2四半期 (実績)	前年同期比	
			(金額)	(増減率)
売上高	147	192	45	31.0%
営業損失	△179	△364	△185	—
経常損失	△176	△376	△200	—
四半期純損失	△47	△366	△319	—

- ✓ 営業損失：VF2後継機となる次世代LSIの開発進捗により研究開発費2億円が先行して発生
- ✓ 経常損失：急激な円高の影響により、為替差損11百万円が発生
- ✓ 四半期純損失：前第2四半期に売却したコグニビュー社の株式売却代金の一部留保金9百万円を受領

2017年3月期 第2四半期 決算概要 (B/S) -前期比-

(単位：百万円)

	2016年 3月末	2016年 9月末	増減額
流動資産	1,984	1,685	△299
固定資産	260	253	△7
資産合計	2,244	1,938	△306
流動負債	226	276	50
固定負債	18	18	0
負債合計	245	294	50
純資産合計	1,999	1,643	△356
負債・純資産合計	2,244	1,938	△306

✓ 自己資本比率は84.6%の高水準を維持

1 2017年3月期 第2四半期 決算説明

2 2017年3月期 通期業績予想

3 中期経営計画と成長イメージ

4 参考資料

2017年 3月期 通期業績予想

(単位：百万円)

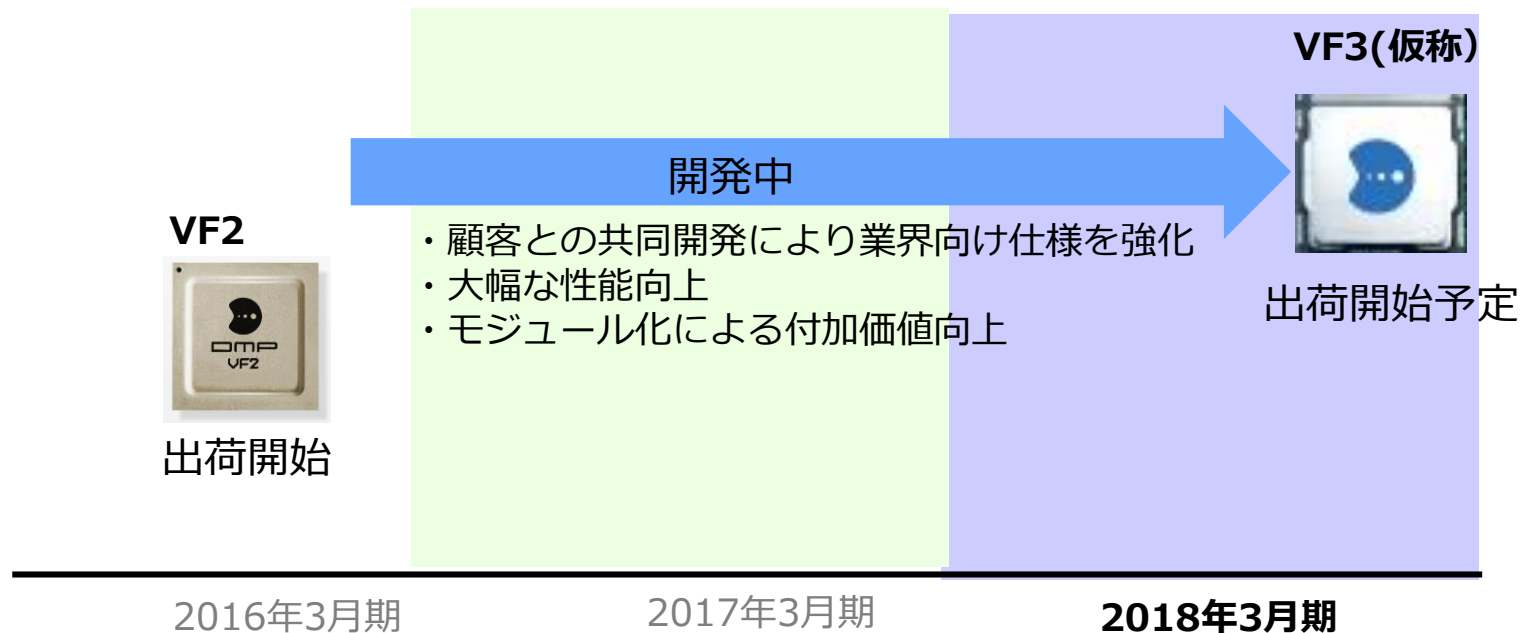
	2016年3月期 (実績)	2017年3月期 (予想)	前期比	
			(金額)	(増減率)
売上高	733	1,000	267	36.3%
営業損失	△176	△161	15	—
経常損失	△193	△161	32	—
当期純損失	△64	△161	△97	—

- 1 2017年3月期 第2四半期 決算説明
- 2 2017年3月期 通期業績予想
- 3 中期経営計画と成長イメージ
- 4 参考資料

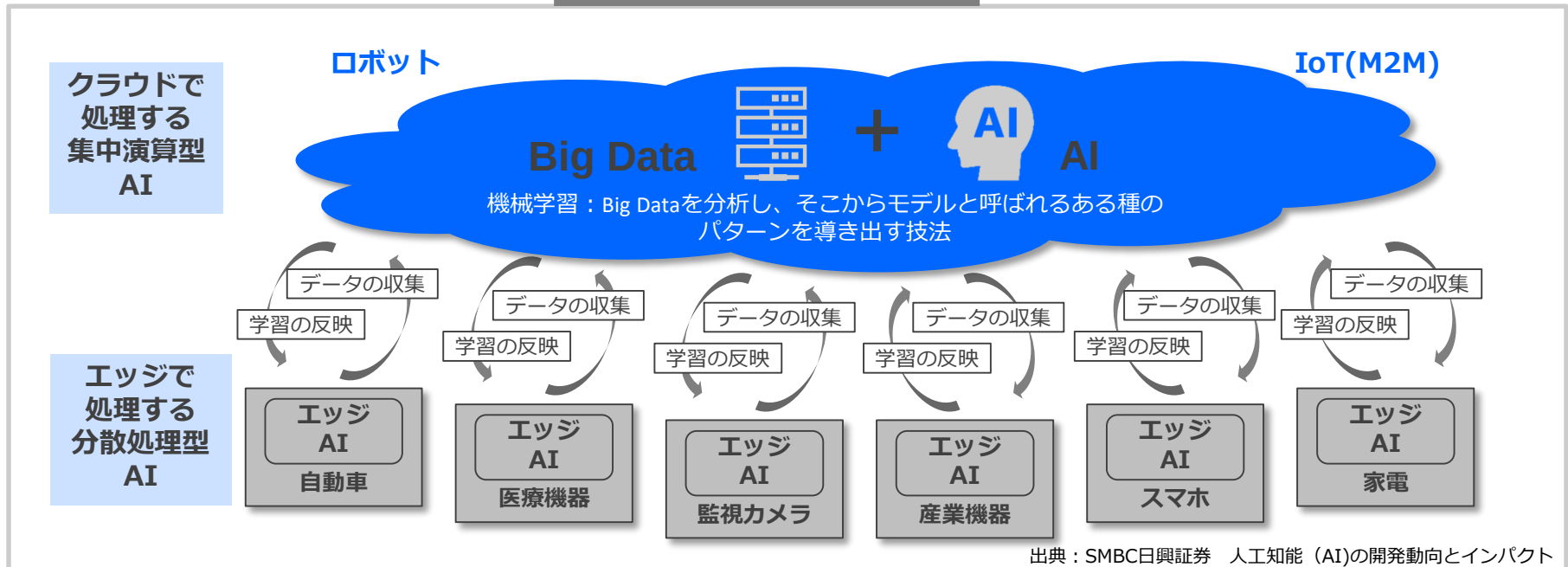
SoC/モジュールビジネス分野

SoC開発、拡販により事業を構築・拡大

グラフィックスLSI「VF2」が出荷開始。
後継チップ「VF3」は顧客から開発受託し順調に進捗。



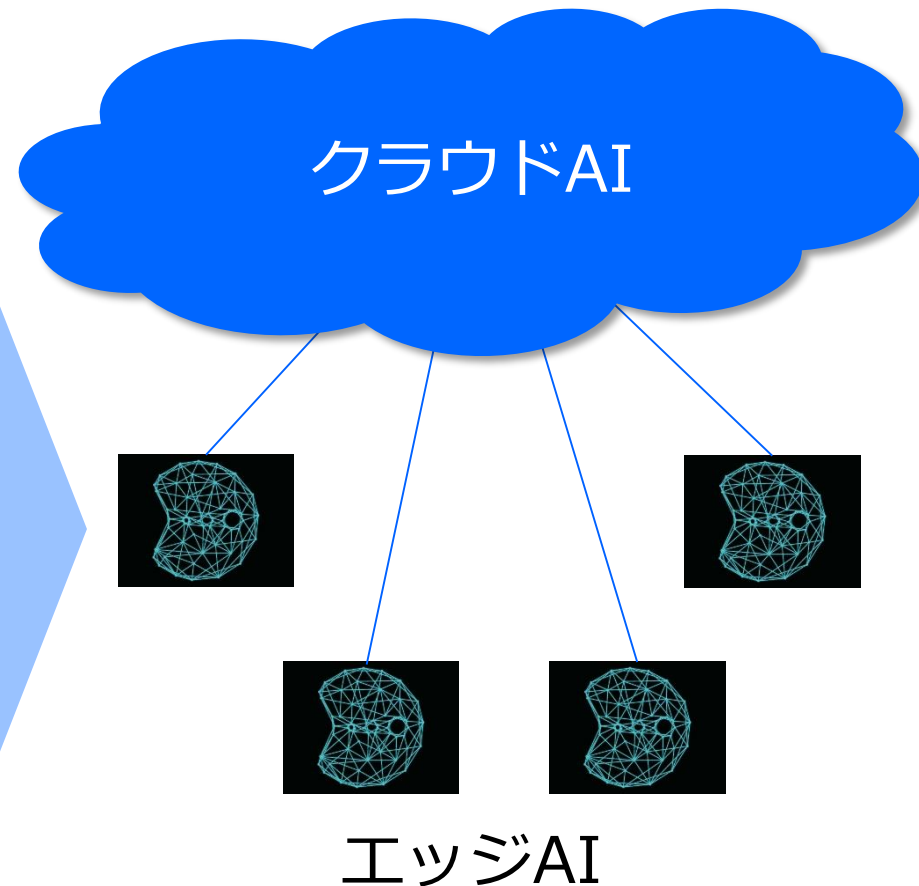
人工知能（AI）を取り巻く環境



出典：SMBC日興証券 人工知能（AI）の開発動向とインパクト

エッジでAI処理する分散処理型AIが増加

- ネットワーク帯域
- リアルタイム性
- プライバシー



DMP GPUコア

低消費電力

高速処理

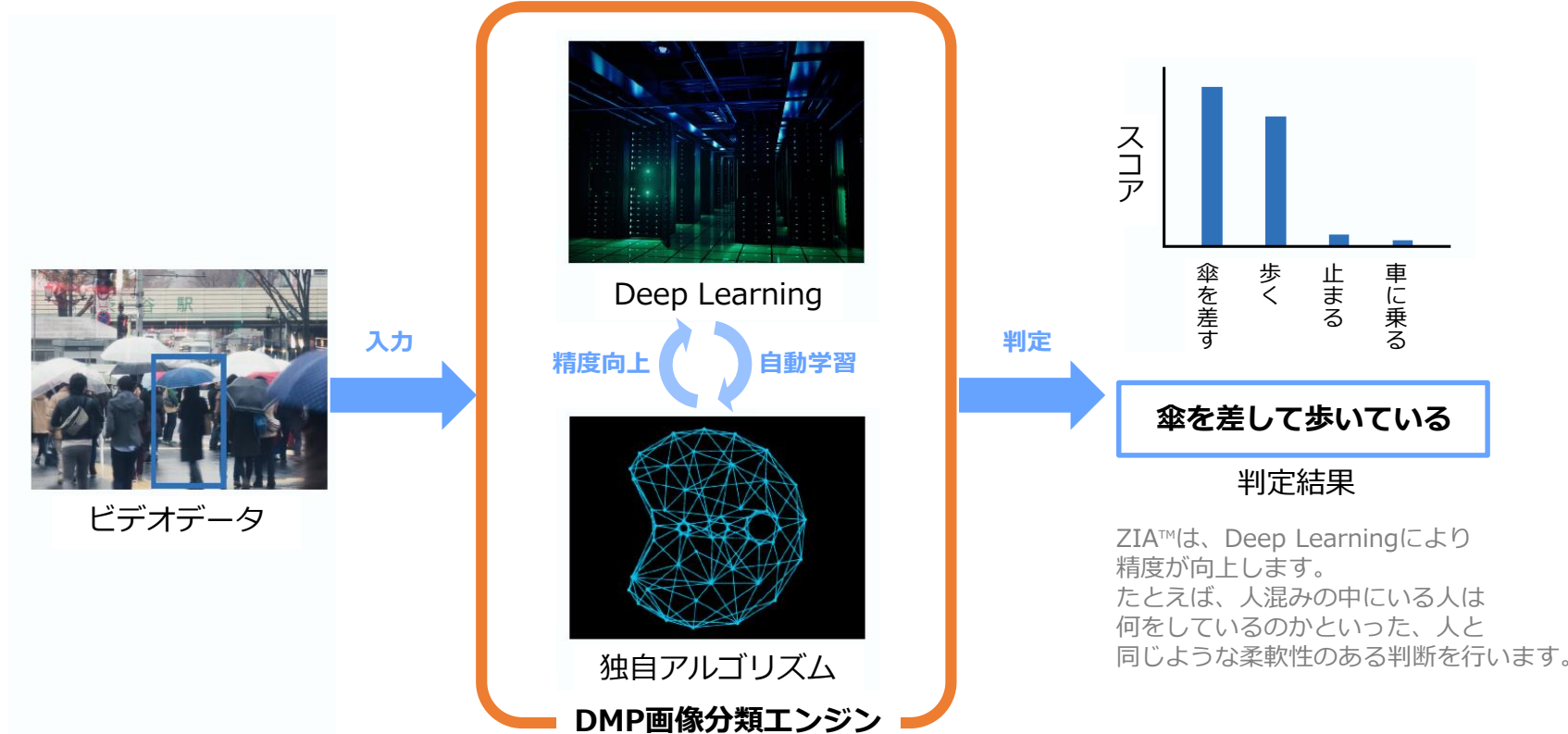
小型
ローコスト

世界でGPUを提供できる4社の1社である
DMPの開発技術力が活かせる分野

ZIA™ Z Intelligent Accelerator

AIを活用したプラットフォーム「ZIA™」を提供開始（2016年11月7日）

- ・ 第一弾として、Deep Learningを用いたDMP画像分類エンジン(以下図参照) を発売
- ・ 今後、AI関連ソフトウェア、省電力AIエンジンを含めたハードウェア製品を順次リリース予定





省電力AIエンジンと異種エンジン統合クラウドによる
人工知能プラットフォームの開発に着手

契約金額DMP分（総額） 475百万円

委 託 期 間 2016年6月～2019年3月まで

プロジェクトの概要

- 人工知能アルゴリズムを従来比10倍以上の処理効率で実行可能にする**省電力AIエンジンの開発**
- クラウド側で異種エンジンを統合する人工知能プラットフォームの開発



当社のAIビジネスを加速



IoT推進のための横断技術開発プロジェクト（平成28年度～平成32年度）

省電力AIエンジンと異種エンジン統合クラウドによる人工知能プラットフォームの開発

委託

エッジAIプラットフォーム開発



省電力AI
プロセッサ開発

再委託

TOSHIBA
パッケージ
実装技術



設計実装ツール開発

クラウドAIプラットフォーム開発

産業技術総合研究所 **AIST**
ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

異種エンジン統合クラウド
システムソフトウェア



異種エンジン統合
アーキテクチャー

アドバイザー企業

DENSO

SECOM

Canon



Sony
Interactive
Entertainment

他

次の付加価値・成長市場への参入

勝てる「アミューズメント市場」で
SoCビジネス基盤確立

フェーズ2 + 成長するAI分野へ拡大

SoC/モジュールビジネス拡大

ZIAプラットフォームを中心とした
AI向け製品（SW/HW）の展開

SoC/モジュール
VF2/次世代SoC

プロフェッショナル
サービス

IPライセンス

フェーズ1

フェーズ2

フェーズ3

- SoCの開発：「勝てる」分野での製品開発
- IPポートフォリオの拡充：画像処理分野への進出
- プロフェッショナルサービス立ち上げ

- モジュール提供による付加価値増大

- AI向けLSI製品

- IPポートフォリオの拡充：省電力AIプロセッサIP

- AIに関連したプロフェッショナルサービス/ソフトウェア製品

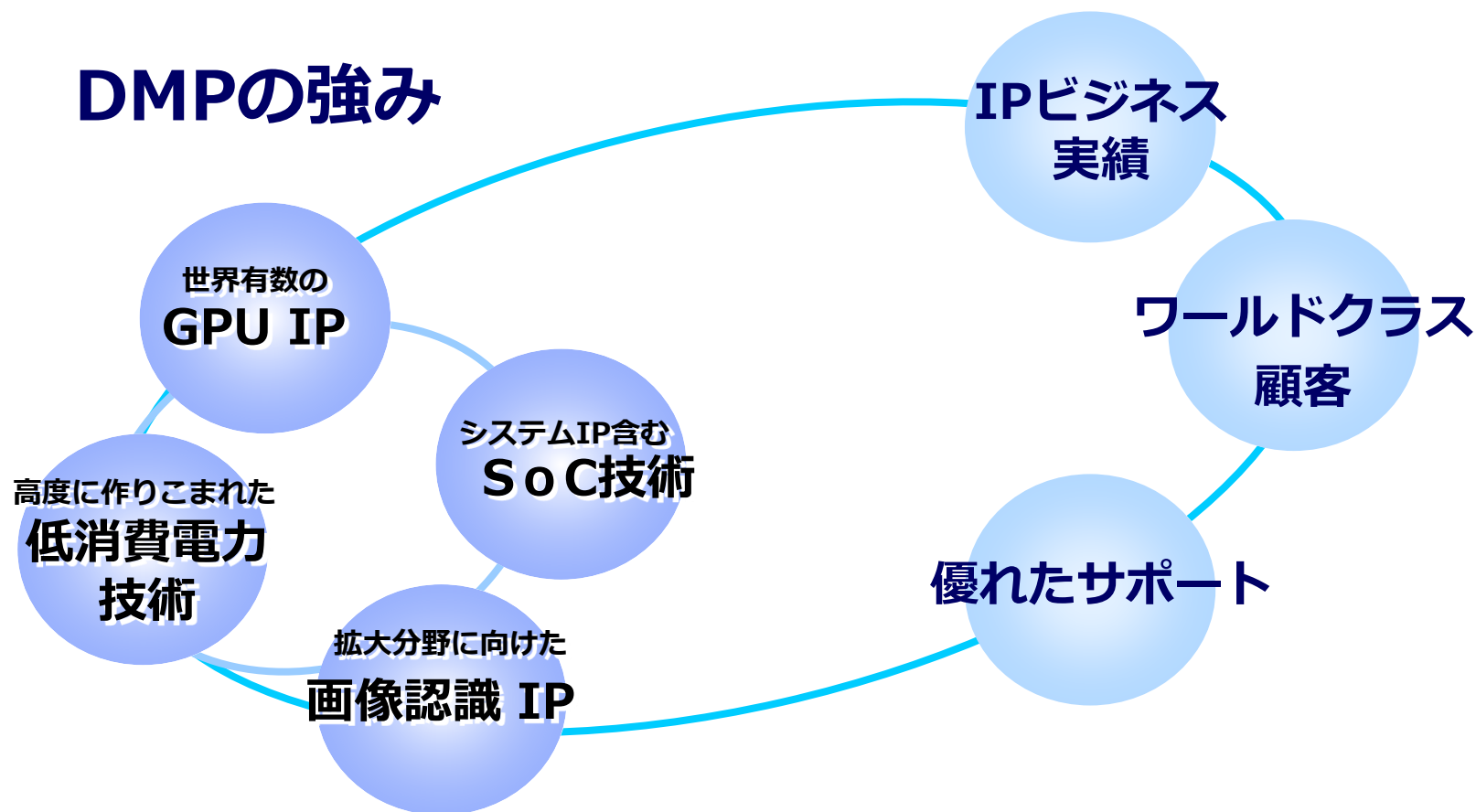
- 1 2017年3月期 第2四半期 決算説明
- 2 2017年3月期 通期業績予想
- 3 中期経営計画と成長イメージ
- 4 参考資料

ビジュアル・コンピューティング*分野の ワンストップ・ソリューション・プロバイダーになる

*ビジュアル・コンピューティング：

グラフィックスないしは画像を介して行うコンピュータ処理総称

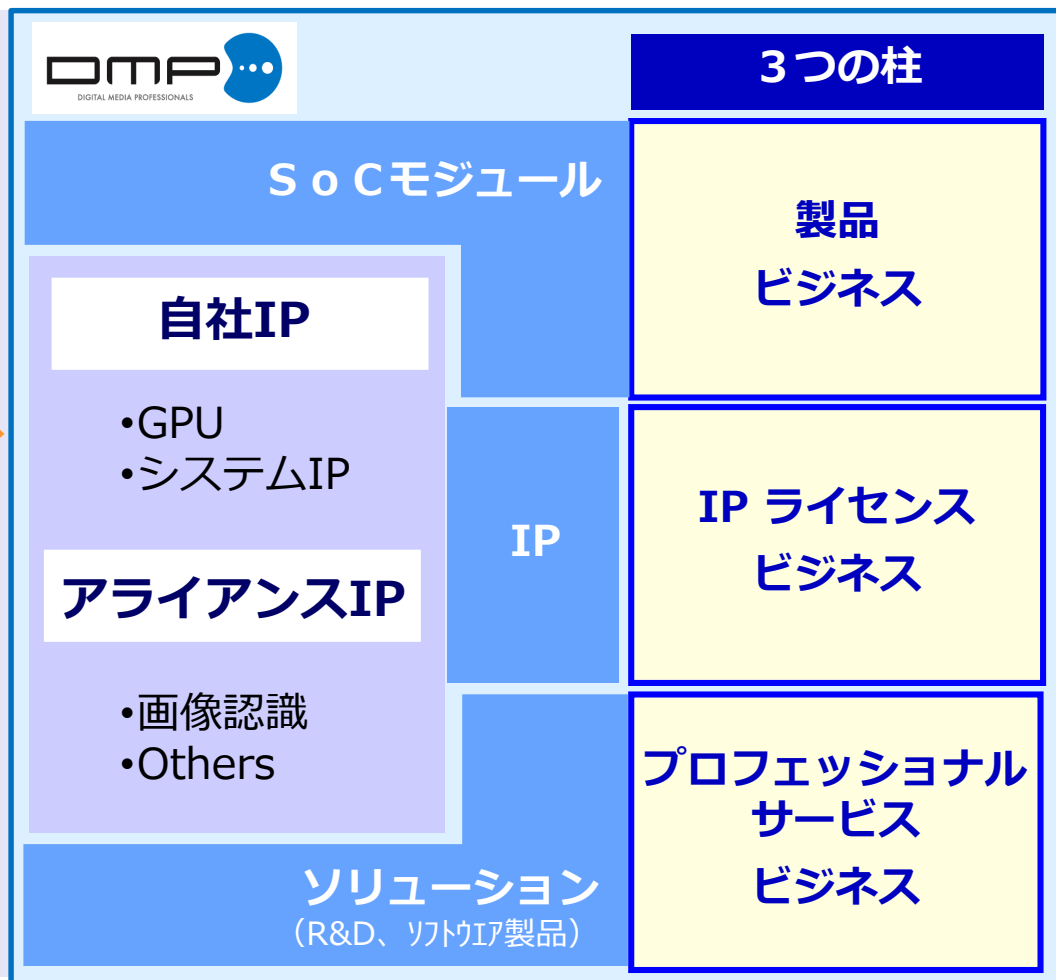
DMPの高い付加価値をもたらす半導体の中核技術とビジネス実績



独自のIPポートフォリオで、特徴のある製品・ライセンス・サービスを提供

グローバル・アライアンス

- ファブレス
- 半導体 IPベンダー
- 商流



ビジュアル
コンピューティング
分野

顧客

- ✓ OEM
- ✓ 半導体ベンダー
- ✓ システム
インテグレーター
- ✓ ソフトウェア
ハウス

強みをフル活用できる「3つの柱」で成長への基盤を構築

製品 ビジネス

自社IPを生かした競争力のあるSoCとソリューションの提供

- 強みを生かし「勝てる分野」でビジネス立ち上げ
- SoC/モジュール提供によるビジネス規模拡大

IP ライセンス ビジネス

成長分野で新規ビジネスを創出

- ビジュアルコンピューティング分野にフォーカス
- ポートフォリオ拡充、提案力強化

プロフェッショナル サービス ビジネス

高い技術力の提供とともに新たな分野開拓への要とする

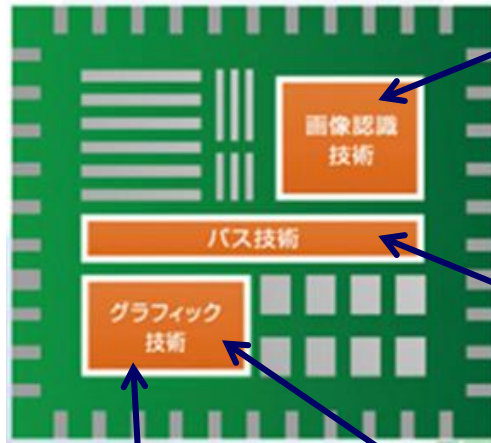
- GPU/ビジョン技術(自社/他社) をベースとした高付加価値サービスの構築
- R & Dの強化

体制・ コーポレート

アライアンスにより経営資源を強化

(商流・半導体開発・IP外部導入のパートナー)

低消費電力・高性能が実証された業界最先端のIPを提供



次世代画像認識プロセッサIP開発中

- ・ Computer Vision用、高性能低消費電力プロセッサ
- ・ 人検出、顔認識、ジェスチャー認識等アルゴリズムライブラリを整備

Loputoシステムシリーズ

SoCインターコネクトIP

- ・ 対応バスプロトコル： AMBA AXI, OCP, ACE I/Fサポート
- ・ マルチレイヤー構成による低レイテンシ、QoSをサポート

DDRメモリコントローラIP

- ・ DDR1/2/3/4, LPDDR1/2/3サポート
- ・ SoCインターフェース： AXI, OCP / ・ DDR PHY インターフェース (DFI)

antシリーズ

UI Drowing Engine IPコア

- ・ 0.5×0.5mm 世界最小コアサイズ
- ・ 低消費電力、高い描画性能、歪み補正



SMAPHシリーズ

3DグラフィックスIPコア

- ・ Khronos最新規格： OpenGL ES 3.0対応
- ・ DMP独自拡張機能 MAESTRO



2DグラフィックスIPコア

- ・ Khronos最新規格： OpenVG1.1対応
- ・ 業界最小のIPコアサイズでフォント、地図、アイコン等のベクターデータのコンテンツを高速描画



成長するビジュアル・コンピューティング市場へフォーカス



ゲーム



ユーザー
インターフェイス



画像認識



自動車運転支援



コネクテッド・ホーム



モバイル・ビジョン



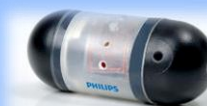
ウェアラブル・
コンピューティング



セキュリティー



ロボット／F A



医療

(従来)

I o T (*) ➡ 日本企業が強い分野で成長

モバイル／P C／T V

自動車／家電／産業／ホーム／医療／セキュリティ

数量

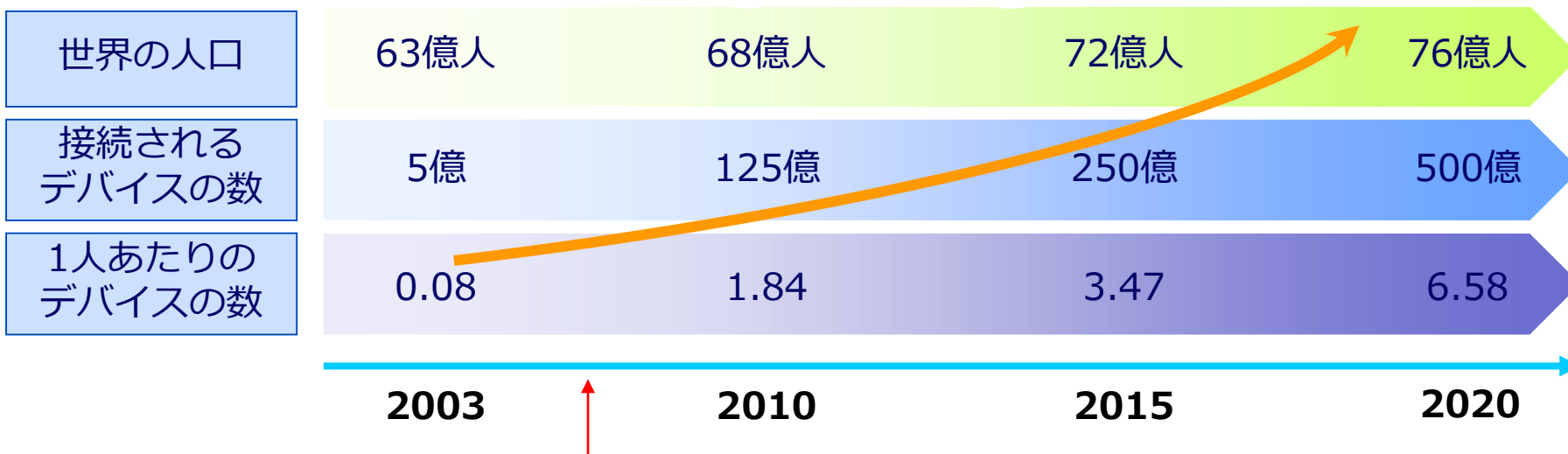


デバイスの種類

*** I o T (Internet of Things) :**

P C、スマホ・タブレット、ゲーム機といった情報通信機器にとどまらず、社会で利用される様々なモノに通信機能を持たせ、インターネットに接続したり、相互に通信することにより、自動認識、自動制御、遠隔計測などが行われること。

I o Tの到来 (出典 : Cisco IBSG.2011)



インターネットに接続されるデバイス数が、世界人口を超える

ビジュアル・コンピューティング分野

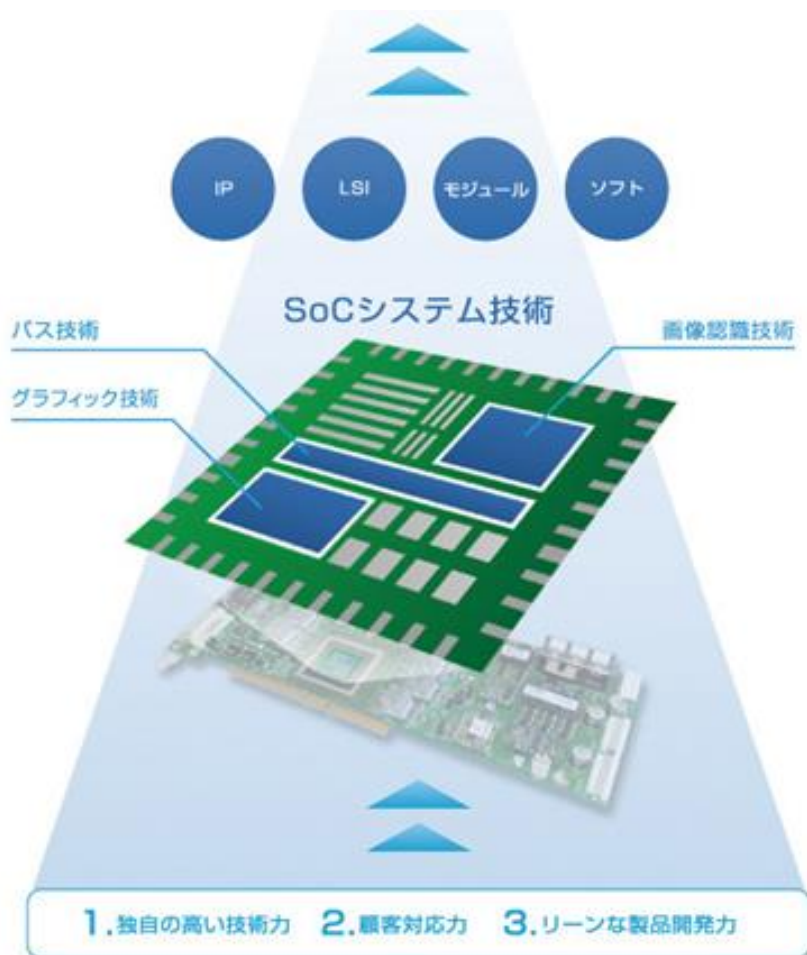
● 付加価値の高いIPコア

- ヘテロジニアスな処理環境を実現する高度なプロセッサIP
(GPGPU/画像認識)
- 低消費電力で最高のシステム性能を実現するSystem IP
- IP性能を引き出す最適化されたソフトウェアツール群

● DMP IPによる差異化されたSoC/モジュール

● プロフェッショナルサービス

- アルゴリズム
- ベンチマーク、最適化
- アプリケーション開発
- 検証



強み、競争優位性を活かした今後の展望

フェーズ1

- SoCの開発
：「勝てる」分野での製品開発
- IPポートフォリオの拡充
：画像処理分野への進出
- プロフェッショナルサービス立ち上げ

フェーズ2

- ワンストップソリューションの提供
- IPポートフォリオの拡充
- IoTに関連したサービスビジネス

